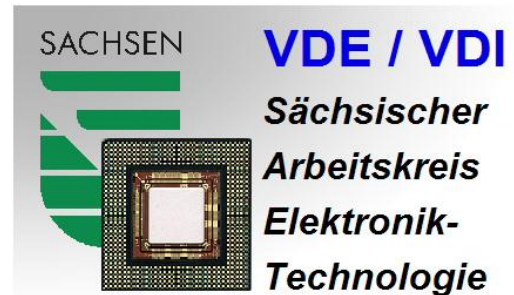


Obmann: Prof. Dr.-Ing. Reinhard Bauer
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden
01069 Dresden
e-mail: bauer@htw-dresden.de

Koordinierung: Dr.-Ing. Martin Oppermann, TU Dresden
e-mail: oppermann@zmp.et.tu-dresden.de



60. Treffen des Sächsischen Arbeitskreises Elektronik-Technologie

Am **Mittwoch, den 21. März 2012**
zum Thema: **Aktuelle Trends in der Montagetechnik**
im Headquarter von **ASM Assembly Systems GmbH & Co. KG** in München

ASM Assembly Systems GmbH & Co. KG
Rupert-Mayer-Strasse 44
81379 München
<http://www.siplace.com>

Programm:

- ab 10:30 Empfang, offene Diskussionsrunde zum Erfahrungsaustausch
- 11:00 Begrüßung und Vorstellung der ASM Assembly Systems GmbH & Co. KG.
Herr Rentzsch, Herr Schindler COO
- 11:30 Vortrag: Innovatives Löten mit Nanotechnologie
Dipl.-Ing. Norbert Heilmann, ASM Assembly Systems
- 12:00 Vortrag: Aufbau einer "lean production" für die Fertigung von SMD-Bestückungsautomaten
Abteilung SCM , ASM Assembly Systems
Herr Cwojdzinski
- 12:30 **Mittagsbuffet**
- ab 13:15 Gruppe 1 / Gruppe 2
Werksführung: Fertigung von SIPLACE-Bestückautomaten, eigene moderne
Elektronikfertigung, Applikationscenter (im Applikationscenter Bestückung eines Demoboard
mit einer SIPLACE) **Herr Bonara / Herr Patzner / Herr Oeckl**
- 13:15 Gruppe 1 : SIPLACE-MaschinenElektronikfertigung.....(ab 14:15 Uhr) Applikationscenter
13:15 Gruppe 2 : Elektronikfertigung... (ab 13:45 Uhr)Applikationscenter.....SIPLACE-Maschinen
- 14:45 **Kaffeepause**
- 15:00 Vortrag: Neueste Leiterplattentechnologie, Jenaer Leiterplatten, **Herr Jens Ohlwein**
- 15:30 Vortrag: Neueste Entwicklungen im Schablonendruck
Dipl.-Ing. Lothar Pietrzak, Dipl.-Ing. Daniel Rudolph, Christian Koenen GmbH
- 16:00 Praktische Vorführung: Löten mit Nanotechnologie am Beispiel von temperatursensiblen LED-
Bauelementen
Dipl.-Ing. Norbert Heilmann, ASM

gegen 16:30 Uhr Ende der Veranstaltung